# ガラス基板上のレーザラテラル結晶化 poly-Si1-xGex TFT の特性

Performance of CLC poly-Si1-xGex TFTs on glass substrates

東北学院大工<sup>1</sup>, 島根大総合理工<sup>2</sup> <sup>0</sup>原 明人<sup>1</sup>、 北原邦紀<sup>2</sup>

Tohoku Gakuin Univ.<sup>1</sup>, Shimane Univ.<sup>2</sup>, <sup>O</sup>Akito Hara<sup>1</sup>, Kuninori Kitahara<sup>2</sup>

E-mail: akito@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

## 【はじめに】

多結晶シリコン (poly-Si) および多結晶ゲルマニウム (poly-Ge) 薄膜トランジスタ (TFT) は、低温・高性能・CMOS 実現可能性から 3D デバイスとして注目されている。 同様に多結晶シリコン・ゲルマニウム (poly-Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>) (原子組成:x) TFT<sup>1,2)</sup>も 3D デバイスとして魅力的である。我々は、大粒径を実現可能な連続波レーザラテラル結晶化(CLC) poly-Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub> 薄膜の結晶構造に対する Ge 組成の影響を研究し、Ge 組成の 増加とともに(111)配向に整った疑似的な単結晶が形成される ことを報告している<sup>3-5)</sup>。更に TFT 特性の Ge 濃度依存性について報告しているが<sup>6)</sup>、本研究では新たに測定した Hall 効果 の結果を含め、ガラス基板上の CLC poly-Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub> 薄膜の電気 的な特性について報告する。

#### 【実験】

厚さ 100 nm、組成 x=0、0.05、0.1、0.3 のアモルファス Si<sub>1-x</sub>Gex をガラス(溶融石英または無アルカリガラス)上に堆積し、CLC により結晶化を行った。レーザのスキャン速度は 40 cm/s で ある。N-ch の TFT を作成した。ゲート長(L)=ゲート幅(W)=10  $\mu$ m であり、ソース・ドレイン方向をレーザスキャン方向と 平行に設定した。ゲート絶縁膜は厚さ 50 nm の PECVD-SiO<sub>2</sub> 膜である。最高プロセス温度は 550℃であり、最後に水素化 を行っている。

## 【結果および考察】

図1は、x=0、0.1のトランスファ特性と出力特性である。図2は、x=0、0.05、0.1に対して、TFT特性から得られた電界効果移動度( $\mu_{FE}$ )、閾値電圧( $V_{th}$ )を整理した結果である。x=0.3のTFTは測定範囲内でオン電流の増加は観測されていない。このことは $V_{th}$ が強く正にシフトしていることを示している。図3はHall 効果の結果である。Ge 組成の増加とともに正孔濃度が増加し、Hall 移動度( $\mu_{Hall}$ )が減少することが確認された。なお、x=0は高抵抗により測定不可である。TFTの $V_{th}$ 特性は、Ge 濃度の増加とともにアクセプターが増加していることを示しており、この結果はHall 効果の正孔濃度の傾向とも一致する。同時に、アクセプター濃度の増加により $\mu_{FE}$ 、 $\mu_{Hall}$ の変化も説明できる。

#### 【まとめ】

Ge 組成 x=0、0.05、0.1、0.3 を有する CLC poly-Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub> 薄膜の 特性を評価した。Ge 組成の増加とともに  $\mu_{FE}$ の減少、正の方 向への V<sub>th</sub>シフト、および subtreshold swing (s.s.)の増加を観 測した。これらは Hall 効果で観測した正孔の発生と良い相関 があり、Ge 含有量の増加に伴い、アクセプターが発生してい ることを示唆している。

## 【謝辞】

本研究は科学研究費基盤(C) 19K04534 によって支援されている。本研究に多大なる貢献を行った元東北学院大学博士前期 課程学生岡部泰典君に感謝する。

## 【参考文献】

1) T. -J. King et al., IEEE Electron Device Lett. 12, 584 (1991). 2) T.-J. Tsu-Jae King et al., IEEE Trans. Electron Devices 41, 1581 (1994). 3) K. Hirose et al., Jpn. J. Appl. Phys. 49 03CA07 (2010). 4) K. Kitahara et al., Jpn. J. Appl. Phys. 50, 115501 (2011). 5) K. Kitahara et al., Jpn. J. Appl. Phys. 54, 021302 (2015). 6) Y. Okabe et al., 2012 AM-FPD, p-13.

